



## (12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 210834983 U

(45)授权公告日 2020.06.23

(21)申请号 201921413713.5

(22)申请日 2019.08.28

(73)专利权人 南京德睿智芯电子科技有限公司

地址 211805 江苏省南京市浦口区桥林街  
道浦口经济开发区步月路29号

(72)发明人 王有龙 陈晔

(74)专利代理机构 南京众联专利代理有限公司

32206

代理人 刘趁新

(51) Int. Cl.

G01R 1/04(2006.01)

G01R 31/28(2006.01)

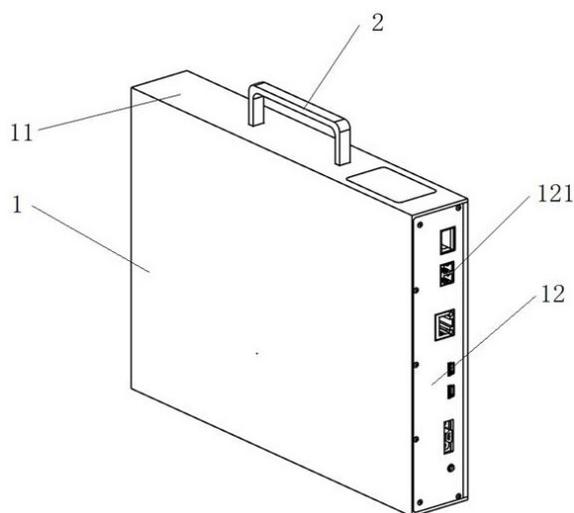
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

### (54)实用新型名称

一种芯片测试平台的保护装置

### (57)摘要

本实用新型提出了一种芯片测试平台的保护装置,包括有箱体,箱体中设置有芯片测试平台PCB板,箱体包括有第一盖板、第二盖板、第三盖板以及第四盖板,第一盖板包括有第一拼板、第二拼板以及第三拼板,第二拼板和第三拼板垂直安装在第一拼板上,第二盖板与第一拼板平行设置,第三盖板和第四盖板相对安装在第一拼板和第二盖板之间,第一盖板内设置有支撑柱,芯片测试平台PCB板通过螺钉固定于支撑柱上,第一盖体上通过螺钉固定安装有透明软垫,本实用新型结构简单,具有良好的整体散热、减震、防尘以及保护功能,由于其具有盒体的保护,也方便使用者携带,不虞携带过程中出现损坏。



1. 一种芯片测试平台的保护装置,其特征在于:包括有箱体(1),所述箱体(1)中设置有芯片测试平台PCB板,所述箱体(1)包括有第一盖板(11)、第二盖板(13)、第三盖板(12)以及第四盖板(14),所述第一盖板(11)包括有第一拼板(111)、第二拼板(112)以及第三拼板,所述第二拼板(112)和第三拼板垂直安装在第一拼板(111)上,所述第二盖板(13)与第一拼板(111)平行设置,所述第三盖板(12)和第四盖板(14)相对安装在第一拼板(111)和第二盖板(13)之间,所述第一盖板(11)内设置有支撑柱(113),所述芯片测试平台PCB板通过螺钉固定于支撑柱(113)上,所述第一盖体上通过螺钉固定安装有透明软垫(3)。

2. 根据权利要求1所述的一种芯片测试平台的保护装置,其特征在于:所述第二盖板(13)上设置有多条散热翅片(133),与其相对的一面上设置有散热凸台(134),所述散热凸台(134)抵于芯片测试平台PCB板表面。

3. 根据权利要求2所述的一种芯片测试平台的保护装置,其特征在于:所述散热凸台(134)与芯片测试平台PCB板之间设置有散热硅胶(4)。

4. 根据权利要求1所述的一种芯片测试平台的保护装置,其特征在于:所述第二盖板(13)相对于第一盖板(11)可拆卸设置,所述第二盖板(13)上设置有多根凸台柱,所述芯片测试平台PCB板上设置有与其相对应的安装孔(5)。

5. 根据权利要求1所述的一种芯片测试平台的保护装置,其特征在于:所述第二盖板(13)上设置有散热口,所述散热口上设置有防尘盖板(132),所述防尘盖板(132)通过磁铁(131)吸附安装在散热口上。

6. 根据权利要求1所述的一种芯片测试平台的保护装置,其特征在于:所述第二拼板(112)上安装有把手(2)。

7. 根据权利要求1所述的一种芯片测试平台的保护装置,其特征在于:所述第三盖板(12)和第四盖板(14)上分别设置有若干插接口。

## 一种芯片测试平台的保护装置

### 技术领域

[0001] 本实用新型具体涉及到一种芯片测试平台的保护装置。

### 背景技术

[0002] 一般芯片测试平台为PCB裸板,在PCB裸板上安装有各种用于测试芯片的电气元器件,形成芯片测试平台,而现有技术中通过芯片测试平台对芯片进行测试则是直接在实验室中进行芯片测试,测重测试方法会导致PCB板及元器件皆裸露在外,无保护容易沾染灰尘,而PCB裸板上的散热器件需要另外贴小的散热冷板,工艺较为复杂,由于芯片测试平台为PCB裸板,也限制了其测试地点,导致其不方便携带。

### 实用新型内容

[0003] 实用新型目的:本实用新型的目的是针对目前技术中的不足,提供了一种芯片测试平台的保护装置,其结构简单,具有良好的整体散热、减震、防尘以及保护功能,由于其具有盒体的保护,也方便使用者携带,不虞携带过程中出现损坏。

[0004] 技术方案:为实现上述目的,本实用新型提供了一种芯片测试平台的保护装置,其特征在于:包括有盒体,所述盒体中设置有芯片测试平台PCB板,所述盒体包括有第一盖板、第二盖板、第三盖板以及第四盖板,所述第一盖板包括有第一拼板、第二拼板以及第三拼板,所述第二拼板和第三拼板垂直安装在第一拼板上,所述第二盖板与第一拼板平行设置,所述第三盖板和第四盖板相对安装在第一拼板和第二盖板之间,所述第一盖板内设置有支撑柱,所述芯片测试平台PCB板通过螺钉固定于支撑柱上,所述第一盖体上通过螺钉固定安装有透明软垫。

[0005] 作为本方案的一种改进,所述第二盖板上设置有多条散热翅片,与其相对的一面上设置有散热凸台,所述散热凸台抵于芯片测试平台PCB板表面。

[0006] 作为本方案的一种改进,所述散热凸台与芯片测试平台PCB板之间设置有散热硅胶。

[0007] 作为本方案的一种改进,所述第二盖板相对于第一盖板可拆卸设置,所述第二盖板上设置有多根凸台柱,所述芯片测试平台PCB板上设置有与其相对应的安装孔。

[0008] 作为本方案的一种改进,所述第二盖板上设置有散热口,所述散热口上设置有防尘盖板,所述防尘盖板通过磁铁吸附安装在散热口上。

[0009] 作为本方案的一种改进,所述第二拼板上安装有把手。

[0010] 作为本方案的一种改进,所述第三盖板和第四盖板上分别设置有若干插接口。

[0011] 有益效果:本实用新型中通过在芯片测试平台PCB板上设置有盒体,通过盒体实现对芯片测试平台PCB板的保护,在盒体中设置有散热翅片,通过散热翅片实现对盒体内部的散热,从而实现对芯片测试平台PCB板的散热,由于将芯片测试平台设置在盒体中,方便移动和携带,盒体内设置有透明软垫,能够防止盒体在移动的过程中对芯片测试平台PCB板产生损坏,还通过设置有防尘盖板,防止灰尘进入到芯片测试平台PCB板上。

## 附图说明

[0012] 图1为本实用新型中芯片测试平台保护装置立体结构示意图；

[0013] 图2为本实用新型中第一盖板结构示意图；

[0014] 图3为本实用新型中俯视结构示意图；

[0015] 图4为本实用新型中无第二盖板的俯视结构示意图；

[0016] 图5为本实用新型中第二盖板背面结构示意图。

[0017] 附图标记列表：1、箱体；2、把手；3、透明软垫；4、散热硅胶；5、安装孔；11、第一盖板；12、第三盖板；13、第二盖板；14、第四盖板；111、第一拼板；112、第二拼板；113、支撑柱；131、磁铁；132、防尘盖板；133、散热翅片；134、散热凸台。

## 具体实施方式

[0018] 下面结合附图和具体实施方式，进一步阐明本实用新型，应理解下述具体实施方式仅用于说明本实用新型而不适用于限制本实用新型的范围。需要说明的是，下面描述中使用的词语“前”、“后”、“左”、“右”、“上”和“下”指的是附图中的方向，词语“内”和“外”分别指的是朝向或远离特定部件几何中心的方向。

[0019] 如图1-5所述的一种芯片测试平台的保护装置，安装方式为：先将把手2和透明软垫3用螺钉固定安装在箱体1上，以方便携带以及防止在携带的过程中产生震动使得芯片测试平台PCB板产生损坏，芯片测试平台PCB板先通过3个螺钉安装到第一盖板11的支撑柱113上并起到定位作用，然后用螺钉安装左右的第三盖板12和第四盖板14；之后安装第二盖板13，安装前，第二盖板13上的散热凸台134上贴有散热硅胶4，第二盖板13上的凸台柱对应芯片测试平台PCB板上的安装孔5，方便紧固芯片测试平台PCB板及安装第二盖板13；之后安装第二盖板13，第二盖板13为可拆卸盖板，用来应对不同的调试方式；最后安装防尘盖板132，防尘盖板132采用磁吸式结构安装。

[0020] 一种芯片测试平台的保护装置，包括有箱体1，所述箱体1中设置有芯片测试平台PCB板，所述箱体1包括有第一盖板11、第二盖板13、第三盖板12以及第四盖板14，所述第一盖板11包括有第一拼板111、第二拼板112以及第三拼板，所述第二拼板112和第三拼板垂直安装在第一拼板111上，所述第二盖板13与第一拼板111平行设置，所述第三盖板12和第四盖板14相对安装在第一拼板111和第二盖板13之间，所述第一盖板11内设置有支撑柱113，所述芯片测试平台PCB板通过螺钉固定于支撑柱113上，所述第一盖体上通过螺钉固定安装有透明软垫3。

[0021] 上述结构中：一种芯片测试平台的保护装置，包括有箱体1，通过将芯片测试平台设置在箱体1中实现对其保护，箱体1包括有第一盖板11、第二盖板13、第三盖板12和第四盖板14，第一盖板11包括有第一拼板111、第二拼板112和第三拼板，第二拼板112和第三拼板垂直安装在第一拼板111上，第二盖板13与第一拼板111相对设置垂直安装在第二拼板112和第三拼板上，形成一个箱体1对芯片测试平台进行保护，在第一盖板11中还设置有用于对芯片测试平台PCB其支撑和固定作用的支撑柱113，在第一支撑板中还设置有透明软垫3，透明软垫3能够防止芯片测试平台在移动和携带的过程中产生损坏。

[0022] 本实施例中：所述第二盖板13上设置有多条散热翅片133，与其相对的一面上设置有散热凸台134，所述散热凸台134抵于芯片测试平台PCB板表面，所述散热凸台134与芯片

测试平台PCB板之间设置有散热硅胶4。

[0023] 上述结构中：在第二盖板13上设置的散热翅片133、散热凸台134以及散热硅胶4，能够通过散热硅胶4将芯片测试平台PBC板产生的热量传递到散热凸台134上通过散热翅片133进行散出，保证了箱体1内部的正常工作温度。

[0024] 本实施例中：所述第二盖板13相对于第一盖板11可拆卸设置，所述第二盖板13上设置有多根凸台柱，所述芯片测试平台PCB板上设置有与其相对应的安装孔5。

[0025] 上述结构中：第二盖板13相对于第一盖板11可拆卸，能够用来应对不同的调试方式，第二盖板13上的凸台柱与安装孔5对应设置通过螺钉方便紧固芯片测试平台PBC板以及安装第二盖板13。

[0026] 本实施例中：所述第二盖板13上设置有散热口，所述散热口上设置有防尘盖板132，所述防尘盖板132通过磁铁131吸附安装在散热口上。

[0027] 上述结构中：散热口用于对箱体内部进行散热，通风，防尘盖板132设置在散热口上通过磁吸式安装，能够防止灰尘通过散热口落入芯片测试平台PBC板上，影响芯片测试结果。

[0028] 本实施例中：所述第二拼板112上安装有把手2。

[0029] 上述结构中，第二拼板112上安装的把手2方便使用者携带。

[0030] 本实施例中：所述第三盖板12和第四盖板14上分别设置有若干插接口。

[0031] 上述结构中：第三盖板12和第四盖板14上的插接口用于插接数据线和电源插头等。

[0032] 本实用新型方案所公开的技术手段不仅限于上述实施方式所公开的技术手段，还包括由以上技术特征任意组合所组成的技术方案。

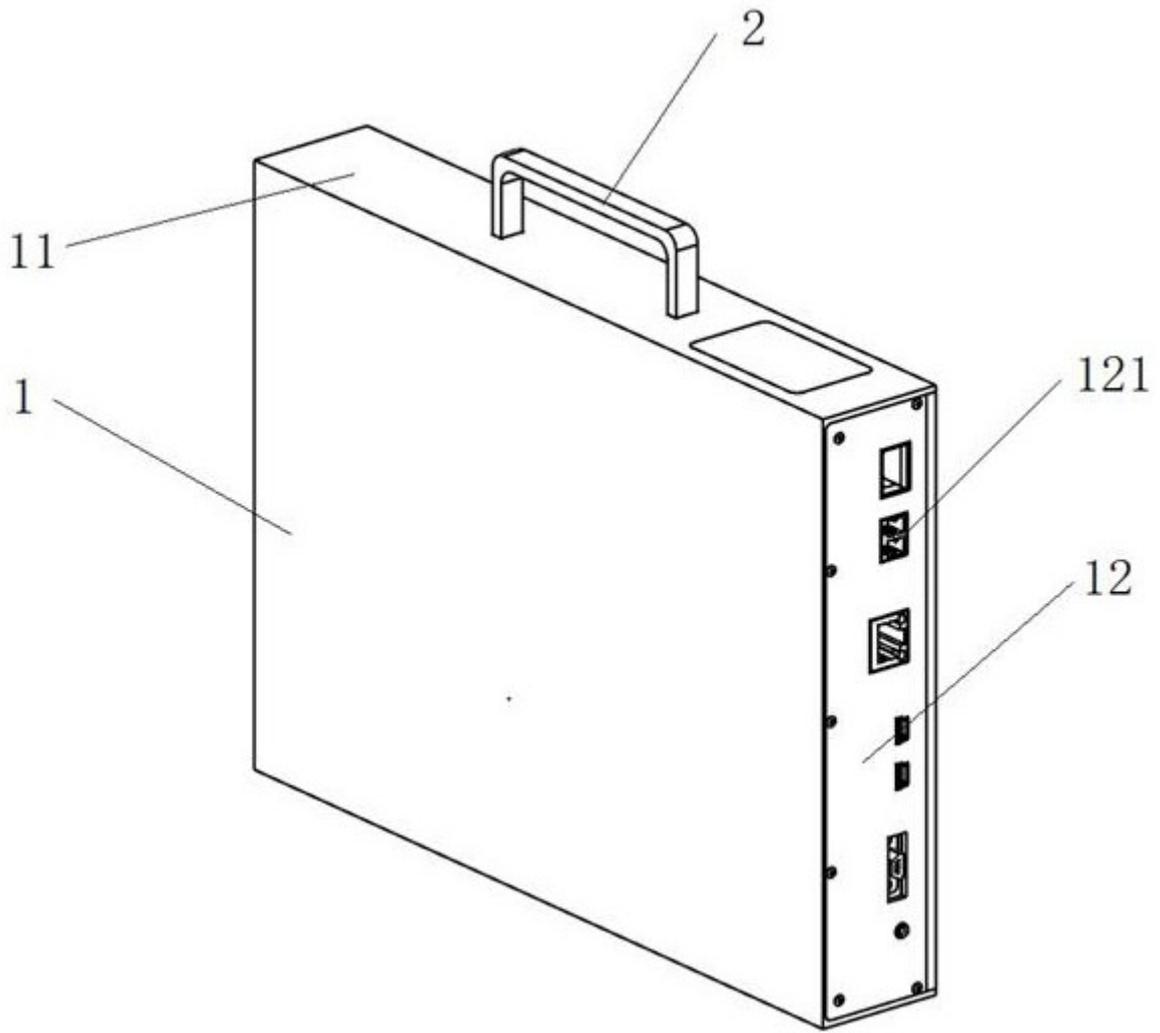


图1

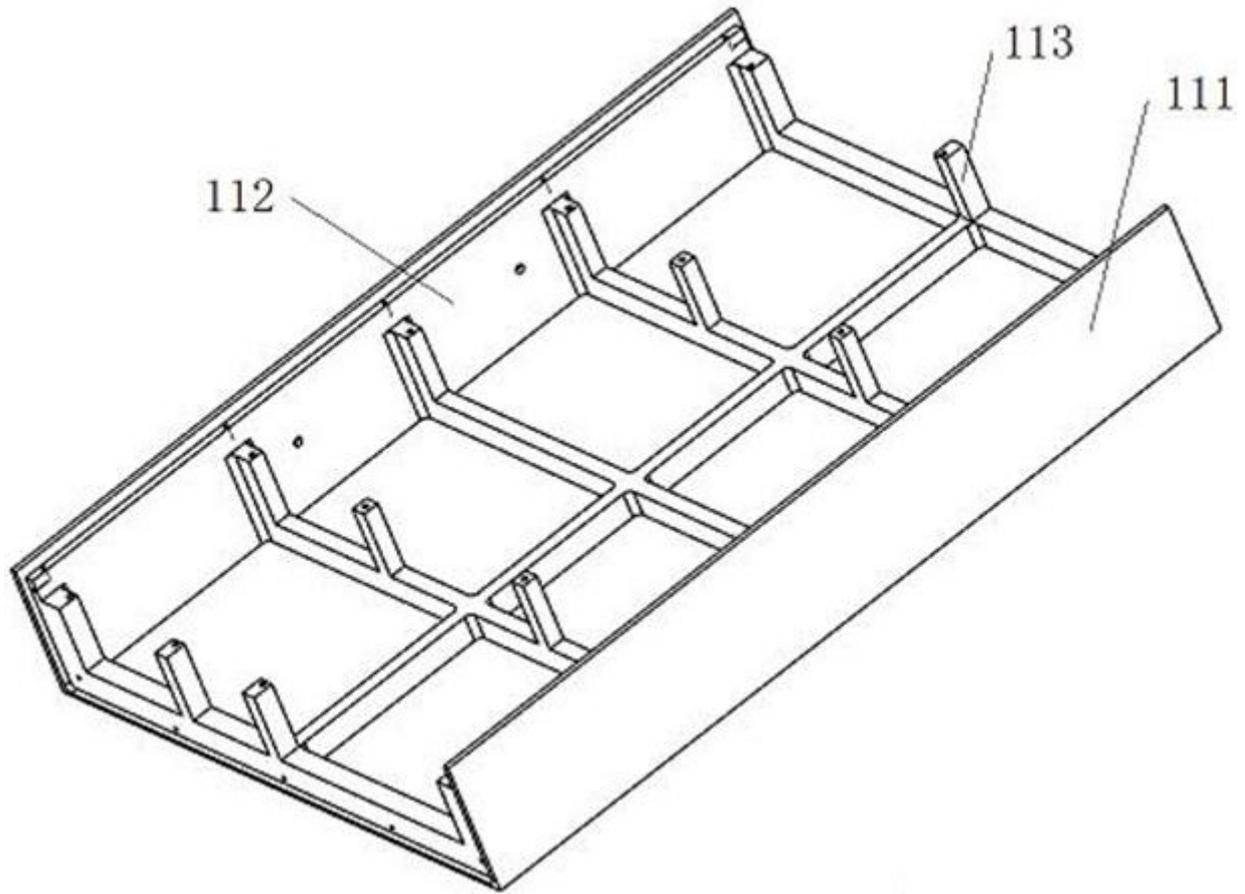


图2

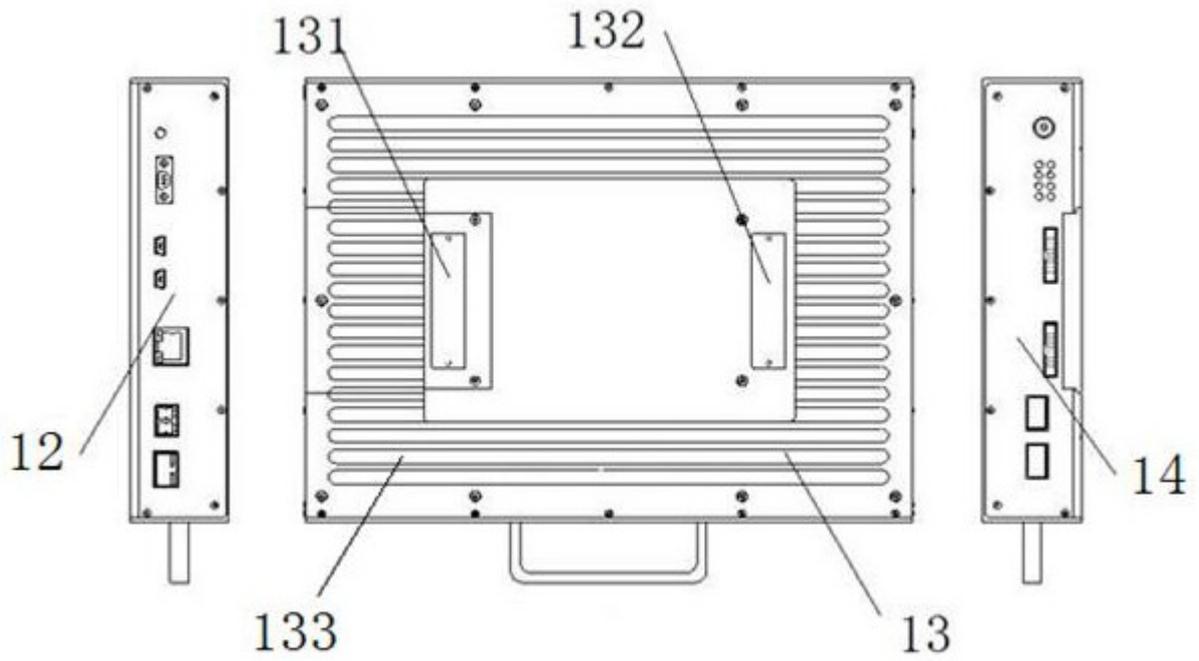


图3

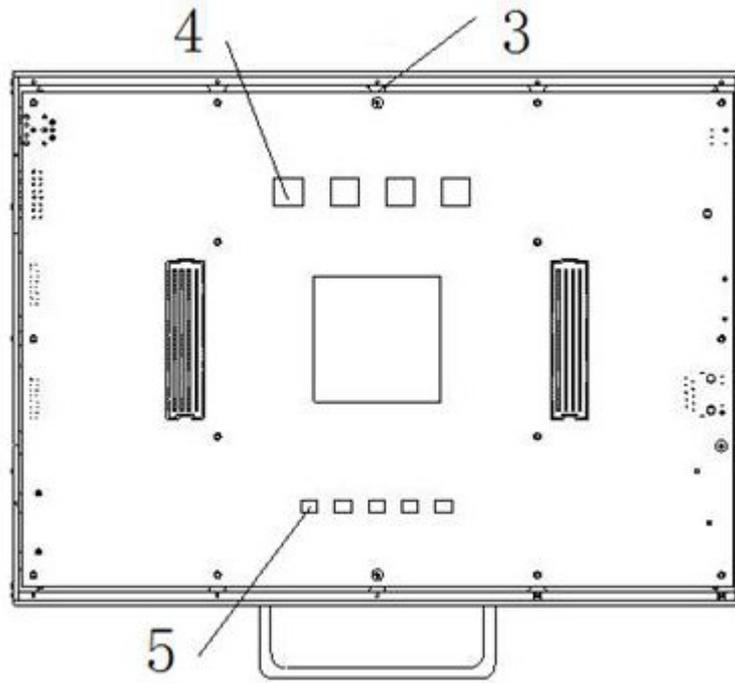


图4

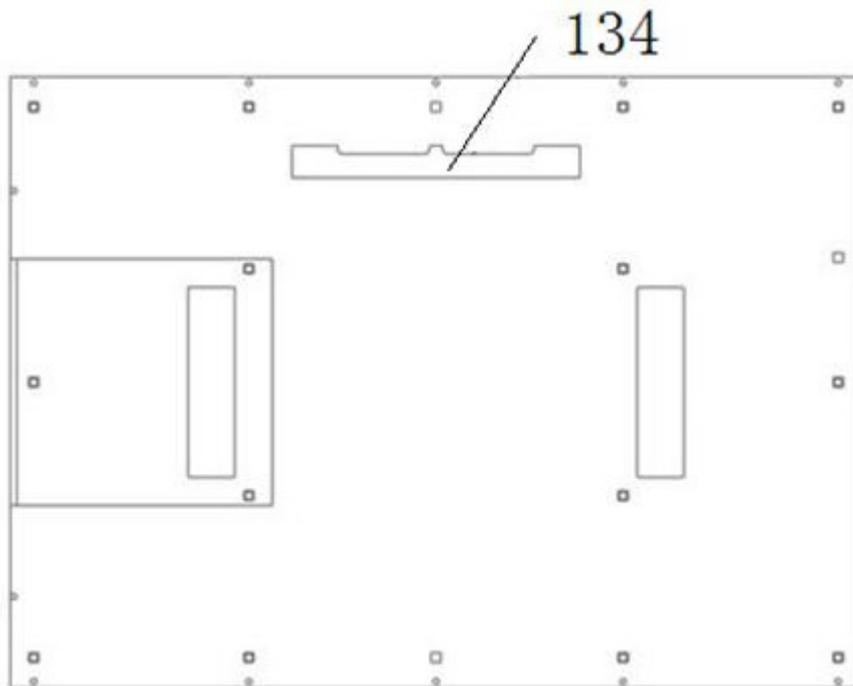


图5